

证券代码：301176

证券简称：逸豪新材

公告编号：2023-004

赣州逸豪新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 169,066,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	逸豪新材	股票代码	301176
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	LIU LEI	钟子宜	
办公地址	江西省赣州市章贡区冶金路 16 号	江西省赣州市章贡区冶金路 16 号	
传真	0797-8334198	0797-8334198	
电话	0797-8339625	0797-8339625	
电子信箱	dmb@yihaoxincai.com	dmb@yihaoxincai.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2022 年，公司实现首发上市。在面对全球经济增长放缓，通胀高位运行，地缘政治局势动荡，国内环境复杂等诸多严峻考验和不确定性的情况下，公司保持稳健经营，不断强化精细化管理，努力夯实内部基础，提升公司内部管理水平，同时统筹规划实施公司发展战略，加大力度推进产品市场认证，不断提升内部管理水平 and 公司价值。报告期内公司持续加快募投项目建设进度，10,000 吨/年铜箔产能建设项目、研发中心项目正在有序进行，争取早日实现预期效益。公司持续推进核心技术攻关，不断提升研发能力，增加研发投入，开展产品工艺研发以及细分行业领域的前瞻性技术的研究，提高高性能电子电路铜箔生产工艺技术水平，积极推进 RTF 铜箔、HVLP 铜箔在客户中的应用，提升铜箔盈利水平；报告期内，公司获评江西省“专精特新”中小企业，公司技术中心入选为江西省省级企业技术中心，公司铜箔产品获评江西省名牌产品。

2022 年度，受全球经济复苏承压、大宗商品价格回落、通胀高企及消费者需求疲软等因素影响，下游行业整体增速放缓，铜箔产品加工费下降，都给公司经营带来不利影响。2022 年度公司实现营业收入 133,470.95 万元，较上年同期增长 5.01%，实现净利润 7,032.58 万元，较上年同期下降 56.81%。其中，2022 年度公司实现铜箔产量 13,163 吨，同比增长 0.99%，实现铜箔销售量 13,088 吨，同比增长 7.32%。公司 PCB 业务投产后，铝基覆铜板逐渐转为自用，随着公司 PCB 产量上升，PCB 耗用铝基覆铜板增加，铝基覆铜板产量上升，销售减少，自用增加，2022 年度公司实现铝基覆铜板产量 158.33 万张，同比增长 41.04%；铝基覆铜板销量 56.45 万张，同比下降 44.28%。2022 年度公司 PCB 产量为 112.69 万平方米，同比增长 430.31%，PCB 销售量为 109.17 万平方米，同比增长 475.49%。2022 年公司持续加大研发投入，研发投入 4,066.82 万

元。

经过多年来的发展，公司较好地把握住市场机遇，在做大做强电子电路铜箔业务的同时，利用自产电子电路铜箔的优势，逐步向产业链下游延伸至铝基覆铜板以及下游 PCB。公司垂直一体化产业链优势可实现产品串联研发，快速匹配下游新产品开发，响应终端客户市场需求。公司 PCB 业务将科技创新与新旧产业进行融合，一方面加强对原应用领域产品的更新迭代，另一方面主动选择发展前景良好与公司发展战略匹配的领域进行重点布局，持续创新，加强技术和人才储备。2023 年度公司 PCB 计划通过提升产能利用率，不断提升 PCB 技术创新、生产管理和服务能力。在现有的单面铝基 PCB、双多层 PCB 等消费类 PCB 产品基础上，提升 PCB 产品结构的多样性和创新性，持续积累提升 PCB 工艺能力，并重点提升工业自动化、智能终端、Mini LED、智能家居、5G 通信、新能源智能汽车等领域 PCB 产品的应用。

（一）公司主营业务

公司致力于成为电子材料领域领先企业，实施 PCB 产业链垂直一体化发展战略。报告期内，公司主要从事电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板、PCB 的研发、生产及销售。公司在 PCB 铜箔和 PCB 领域均与业内知名企业建立了长期合作关系，取得了该等企业的供应商认证，公司主要客户包括生益科技、南亚新材、健鼎科技、景旺电子、胜宏科技、中京电子、中富电路、世运电路、兆驰光源、聚飞光电、芯瑞达、TCL、视源股份、LG 等。公司产品能够有效满足客户对产品性能、规格、质量等各项要求，树立了良好的市场口碑。

（二）公司主要产品

1、电子电路铜箔

电子电路铜箔系以铜为主要原料，采用电解法生产的铜箔，主要作为覆铜板、印制电路板中用于连接各个电子元器件的导体，是覆铜板和印制电路板生产的主要材料之一。

根据中国电子材料行业协会覆铜板材料分会（CCLA）数据，2020 年我国电子电路铜箔需求量中，PCB 用电子电路铜箔占比 28.57%，覆铜板用电子电路铜箔占比 71.43%。与行业内企业多以覆铜板客户为主不同，公司电子电路铜箔客户中 PCB 客户占比高。

基于产业链优势，公司对 PCB 客户的需求有较为全面和深入的理解，建立了高度柔性化的生产管理体系，能够快速响应 PCB 客户在厚度、幅宽和性能等方面的多样化产品需求，有效契合 PCB 客户铜箔订单“多规格、多批次、短交期”的特点。公司电子电路铜箔产品规格丰富，涵盖超薄铜箔、薄铜箔、常规铜箔和厚铜箔等种类，覆盖范围广泛，主要产品规格有 12 μm 、15 μm 、18 μm 、28 μm 、30 μm 、35 μm 、50 μm 、52.5 μm 、58 μm 、70 μm 、105 μm 等，销售最大幅宽为 1,325mm。

2、铝基覆铜板

铝基覆铜板属于金属基覆铜板的一种，由导电层、绝缘层、金属基层组成，其中导电层经过蚀刻可形成印制电路，绝缘层主要起粘接、绝缘和导热的功能，金属基层主要用于满足铝基覆铜板的散热、机械性能等需求。公司凭借自有铜箔生产线的垂直产业链优势，可以根据下游客户的个性化需求，进行铝基覆铜板产品的定制化生产。


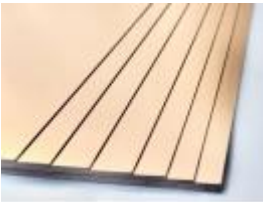


公司掌握了铝基覆铜板全制程生产技术，公司铝基覆铜板产品使用自产电子电路铜箔，具有技术先进、规格齐全、品质稳定、交期及时、低成本等优势。公司铝基覆铜板主要应用于 LED 下游应用行业，如 LED（含 MiniLED）背光、LED 照明等。

3、PCB

印制电路板（PCB）主要为电子信息产品中的电子元器件提供预定电路的连接、支撑等功能，发挥了信号传输、电源供给等重要作用。公司主要为 LED、电子信息制造业相关领域的客户提供定制化的 PCB 产品。目前公司 PCB 产品主要为单面铝基 PCB、双多层 PCB。

公司已研发出可应用于 Mini LED 的铝基 PCB 产品，可满足下游 Mini LED 领域客户对技术指标、产品性能等要求，公司铝基 Mini LED PCB 产品已经通过瑞丰光电（300241.SZ）应用于 TCL 的 TV 产品中。

公司主要产品介绍如下：

名称	产品	产品下游	终端应用
电子电路铜箔		覆铜板、PCB	消费电子、5G 通讯、物联网、大数据、云计算、人工智能、新能源汽车等
铝基覆铜板		铝基 PCB	LED（含 MiniLED）背光、LED 照明等
PCB	 （铝基 PCB）	LED 背光、LED 照明、消费电子、通讯电子、汽车电子等	LED（含 MiniLED）、仪表盘、车灯、GPS、影音系统、工控电源、电力电源、UPS、5G 通讯、智能制造、智能家电、物联网等
	 （双多层 PCB）		

（二）经营模式

1、盈利模式

报告期内，公司主要通过为客户提供电子电路铜箔、铝基覆铜板和 PCB 产品来获取合理利润。公司紧跟下游行业发展趋势，不断进行研发和技术创新，对生产工艺进行优化改进，能够快速响应市场的变化和下游客户的需求，同时通过提高运营管理能力以降低经营成本，提升公司的行业竞争力和盈利能力。

2、采购模式

报告期内，公司外购的原材料主要原材料为铜、铝板，其中铜是电子电路铜箔生产的主要原材料；铝板和电子电路铜箔（自产）是铝基覆铜板生产的主要材料；铝基覆铜板（自产）和 FR4 覆铜板是公司 PCB 的主要材料。铜和铝属于大宗商品，市场价格透明，货源充足。公司拥有稳定的采购渠道，与供应商建立了良好的合作关系。

公司建立了较为完善的采购管理体系，下设供应部，负责采购的实施和管理，根据销售计划和生产需求定期制定采购计划。公司制定了《合格供应商名录》，从质量、交货周期、供货价格和服务等方面对供应商进行考核，确保原材料供应的品质合格、货源稳定，控制原材料的采购成本。

3、生产模式

公司建立了较为完善的生产管理体系，公司电子电路铜箔生产具有连续生产特点，公司综合考虑铜箔产能与客户订单情况制定生产计划。公司铝基覆铜板生产结合行业需求、客户订单情况制定生产计划。公司 PCB 生产根据客户订单情况制定生产计划。生产部门根据客户需求进行工艺配置，根据生产计划安排生产。

在生产过程中，品质部门和生产部门定时、定量对生产各个工序的在产品进行性能检测和外观监控，对产品生产全流程进行质量监控和管理。产品经品质部检验后包装入库。

4、销售模式

公司拥有优质且长期合作稳定的客户群体，主要以上市公司以及细分行业的龙头企业为主，同时存在少量贸易商。一方面公司通过定期的品质回访，与客户研发团队定期开展技术交流，响应客户最新需求，有针对性地进行客户维护以及新产品的开发；另一方面公司通过行业研讨会、市场调研、相关行业研究与期刊等多种途径，主动选择发展前景良好与自身发展战略匹配的公司，有针对性地进行新客户开发，创造业务合作的机会。

公司电子电路铜箔产品采用“铜价+加工费”的定价模式，以长江有色金属现货铜价作为基准铜价，根据铜价、加工费、产品规格等因素，并综合考虑市场供需关系，与客户协商确定。铝基覆铜板产品销售价格系根据生产成本，并参考市场价格、供需关系等因素，与客户协商确定。PCB 产品销售价格系根据生产成本、生产工艺等因素，与客户协商确定。

（二）公司产品市场地位、竞争优势与劣势

1、公司产品市场地位

电子电路铜箔是覆铜板和印制电路板制造的重要材料，印制电路板作为现代各类电子设备中的关键电子元器件，广泛应用于消费电子、5G 通讯、物联网、大数据、云计算、人工智能、新能源汽车、工控医疗等众多领域。

公司深耕于电子电路铜箔及 PCB 行业，公司客户主要以上市公司以及细分行业的龙头企业为主，先后与生益科技、南亚新材、健鼎科技、景旺电子、胜宏科技、中京电子、中富电路、世运电路、兆驰光源、聚飞光电、芯瑞达、TCL、视源股份、LG 等行业内知名企业建立了稳定的合作关系。基于产业链优势，公司对 PCB 客户的需求有较为全面和深入的理解，建立了高度柔性化的生产管理体系。公司电子电路铜箔产品能够快速响应 PCB 客户在厚度、幅宽和性能等方面的多样化产品需求，有效契合 PCB 客户铜箔订单“多规格、多批次、短交期”的特点。

经过多年来的发展，公司较好地把握住市场机遇，在做大做强电子电路铜箔业务的同时，利用自产电子电路铜箔的优势，逐步向产业链下游延伸。2017 年公司铝基覆铜板生产线投产，2021 年第三季度公司 PCB 项目一期开始试生产，公司成功将产品拓展至铝基覆铜板、PCB。公司掌握电子电路铜箔、铝基覆铜板和 PCB 生产核心技术，可实现产品串联研发，快速匹配下游新产品开发，响应终端客户市场需求。公司铝基覆铜板使用自产铜箔，公司 PCB 产品使用自产铜箔和铝基覆铜板，具有技术先进、规格齐全、品质稳定、交期及时、低成本等优势。公司现已成为行业内为数不多的具有 PCB 垂直一体化产业链布局的企业。并且随着公司产品的产销量扩大、客户数量和质量的提升、产品及工艺技术升级，公司的市场竞争力和市场地位也在提高。

公司坚持“以品质谋效益，以创新求发展”的经营理念，致力于成为电子材料领域领先企业。公司系国家高新技术企业、江西省“专精特新”中小企业，公司技术中心入选为江西省省级企业技术中心，公司电子电路铜箔系江西省名牌产品。公司具备较强的研发实力，注重工艺技术提升，经过多年的研发，公司已取得 124 项专利，其中发明专利 35 项，实用新型专利 89 项。公司建立了完善的管理体系，通过了知识产权管理体系、ISO 9001:2015 质量管理体系、IATF 16949:2016 质量管理体系、ISO 14001:2015 环境管理体系、ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系和安全生产标准化 III 级企业等认证。此外，公司电子电路铜箔、铝基覆铜板和 PCB 产品符合 RoHS、REACH 等的要求，铝基覆铜板还通过 ULCCN:QMTS2 MOT130 认证；PCB 产品已通过中国 CQC 和美国 UL 认证。公司产品满足了客户对产品性能、规格、质量等各项要求，树立了良好的市场口碑，赢得了市场的信任。

2、竞争优势与劣势

（1）竞争优势

①垂直一体化产业链优势

公司致力于成为电子材料领域领先企业，实施 PCB 产业链垂直一体化发展战略。报告期内，公司主要从事电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板、PCB 的研发、生产及销售。公司 PCB 项目一期已于 2021 年第三季度开始试生产，随着公司 PCB 项目的投产，公司垂直一体化产业链优势得到进一步加强，可实现产品串联研发，快速匹配下游新产品开发，响应终端客户市场需求。公司实现了 PCB 关键材料的自产，有利于公司产品质量水平的长期稳定，同时关键原材料自产也为公司产品带来了成本优势。

②客户资源优势

公司在铜箔行业深耕十余年，经过多年发展，依靠稳定的产品供给、过硬的产品质量、完善的服务体系赢得了众多知名客户的信赖，与生益科技、南亚新材、健鼎科技、景旺电子、胜宏科技、中京电子、中富电路、世运电路等行业内知名企业建立了稳定的合作关系。经过多年来的发展，公司较好地把握住市场机遇，在做大做强电子电路铜箔业务的同时，利用自产电子电路铜箔的优势，逐步向产业链下游延伸。公司铝基覆铜板先后与湖北碧辰科技股份有限公司、赣州金顺科技有限公司、万安溢升电路板有限公司等客户建立了合作关系，产品终端应用于小米、海信、创维、TCL 等品牌。公司 PCB 业务已与兆驰光源、聚飞光电、芯瑞达、TCL、视源股份、LG 等境内外知名企业建立了合作关系，进入其供应商体系，并实现批量供货。目前公司已经成为兆驰光源、芯瑞达铝基 PCB 的主要供应商，产品质量得到了上述知名客户认可，产品品质市场反馈良好。

公司的主要客户多为行业内的标杆企业，具有良好的市场形象及商业信誉，在行业中处于领先地位。通过进入该等客户的供应商体系，有利于公司获得行业内潜在客户的认可，便于公司业务持续快速拓展；同时下游客户对公司产品各方面性能指标的高标准严格要求，有助于推动公司持续不断进行技术创新和产品研发，稳固公司的研发和产品优势。

③柔性化生产优势

PCB 在叠板和压合过程中根据不同的排板组合需要不同幅宽的铜箔，同时 PCB 产品下游应用领域广泛，不同应用领域对 PCB 产品及其所用铜箔亦有不同的厚度和性能要求，例如智能手机中的 HDI 板需要使用 12 μm 超薄铜箔，大功率大电流电源板需要使用 70 μm -105 μm 的厚铜箔。基于产业链优势，公司对 PCB 客户的需求有较为全面和深入的理解，建立了高度柔性化的生产管理体系，能够快速响应 PCB 客户在厚度、幅宽和性能等方面的多样化产品需求，有效契合 PCB 客户铜箔订单“多规格、多批次、短交期”的特点。公司电子电路铜箔产品规格丰富，涵盖超薄铜箔、薄铜箔、常规铜箔和厚铜箔等种类，覆盖范围广泛，主要产品规格有 12 μm 、15 μm 、18 μm 、28 μm 、30 μm 、35 μm 、50 μm 、52.5 μm 、58 μm 、70 μm 、105 μm 等，销售最大幅宽为 1,325mm。

公司的柔性化生产管理增强了客户粘性，促进公司与客户保持长期稳定的合作关系，同时公司在 PCB 行业中的客户积累和良好口碑，有利于公司获得 PCB 行业内潜在客户的认可，便于公司业务持续快速拓展，提升了公司柔性化生产的规模化效应。

④技术研发优势

公司高度重视产品、技术的研发和提升，不断提高研发投入。公司在全面发展生产技术的同时，始终紧跟下游行业的发展趋势，专注于本领域的技术研发，形成并拥有多项自主研发的核心技术，包括电解铜箔生箔机设计及工艺优化技术，电解铜箔表面处理机设计及工艺优化技术，抗剥高温耐衰减、深度细微粗化表面处理工艺技术，铝基覆铜板全自动连线生产技术，铝基覆铜板用涂胶铜箔工艺配方及生产技术等。公司已取得专利 124 项，其中发明专利 35 项，实用新型专利 89 项。

经过多年发展，公司逐步掌握了铜箔生产后处理设备的研发、设计与操作工艺，具备设备创新研发能力。公司铜箔后处理设备采用自主设计、零部件委托加工、自主组装的模式，提升了设备的适用性和先进性，提高了生产效率和产品品质，提升了公司的竞争能力。

⑤产品优势

公司电子电路铜箔产品的规格丰富，涵盖超薄铜箔、薄铜箔、常规铜箔和厚铜箔，覆盖范围广泛，主要产品规格有 12 μm 、15 μm 、18 μm 、28 μm 、30 μm 、35 μm 、50 μm 、52.5 μm 、58 μm 、70 μm 、105 μm 等，销售产品最大幅宽为 1,325mm。多年来，公司持续跟踪市场变动趋势和客户产品需求，提升产品的各项性能指标。通过多年来持续的研发和工艺改进，公司铜箔产品由常规 STD 铜箔持续升级演进，在抗拉性、延伸性、耐热性、抗剥离强度等性能指标上不断提升，目前公司已研发生产 HDI 用超薄铜箔和 105 μm 厚铜箔等原先依赖进口的高性能铜箔；高频高速铜箔方面，HVLP 铜箔、RTF 铜箔已向客户送样，目前正处于测试验证阶段。

（2）竞争劣势

公司经过多年发展，积累了丰富的电子电路铜箔生产技术，掌握了多项核心技术。通过持续优化生产工艺，设备改进，提高管理效能，在不断创新突破的同时，2022 年公司电子电路铜箔年产量达到 13,163 吨，产能利用率突破了 129%。公司现有电子电路铜箔生产线产能利用率持续位于高位，已难以提升产量，而客户订单持续处于较为饱和状态，现有产能对公司与已有客户进一步加强合作以及新客户开发产生了制约因素，不利于公司在市场竞争中占据主动。

公司将借助募投项目“年产 10,000 吨高精度电解铜箔项目”，扩大产量，优化产品结构，在强化与已有客户合作的同时，开发与公司发展战略匹配的优质客户，以差异化、定制化高端产品以及规模效应，提升公司的盈利能力，为公司业绩增长提供驱动力。

（三）主要的业绩驱动因素、业绩变化

1、业绩驱动因素

国家产业政策、行业供需情况、行业竞争情况、技术创新能力等因素为业绩驱动的关键因素。

（1）国家产业政策

电子电路铜箔、铝基覆铜板和 PCB 属于国家鼓励和扶持的行业，国家一系列产业政策及指导性文件的推出，为公司所处行业的健康发展提供了良好的制度与政策环境。国家政策支持是公司持续发展的有力保障。行业政策变动是影响公司盈利能力重要的因素之一。

（2）行业供需情况

公司主要从事电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板、PCB 的研发、生产及销售。电子电路铜箔、铝基覆铜板和 PCB 的下游应用市场较为广阔，终端应用涵盖了消费电子、5G 通讯、物联网、大数据、云计算、人工智能、新能源汽车、工控医疗、航空航天等行业，庞大的电子信息产业终端市场为铜箔行业提供了广阔的市场空间。但电子信息产业终端产品的需求受全球政治环境、宏观经济、经济周期等一系列因素的影响，下游需求旺盛时，带动 PCB 及下游铜箔等材料行业需求的发展，提升行业景气度，另一方面，近年来，在新能源汽车行业的带动下，铜箔行业扩产速度加快，电子电路新增产能释放或拟建锂电铜箔产能向电子电路铜箔产能转移，则可能会导致铜箔行业供给增加，行业竞争加剧，改变铜箔行业的市场供需情况，进而影响铜箔行业企业的业绩水平。

（3）行业竞争情况

随着终端应用市场的发展，电子电路铜箔行业的景气度提升。电子电路铜箔的市场需求量将会持续增长，将吸引越来越多新企业进入或现有企业扩大生产规模，加剧行业竞争。整体而言，新进入厂商技术积累、研发能力、客户积累等较为薄弱。

随着 5G 通信技术的应用、汽车电子产品技术的更迭，行业下游客户的产品性能更新加速，消费者偏好变化加快，在此背景下，拥有领先的技术研发实力、高效的产品批量供货能力、良好的产品质量、优质客户资源的铜箔企业才能在市场竞争中拥有竞争优势，获得更大的市场份额。

（4）技术创新能力

技术创新是公司保持持续发展的核心驱动力，对公司的长期盈利能力具有重大影响。技术提升、工艺改进将提高公司产品的市场竞争力，增强公司的盈利能力。

2、业绩变化

2022 年公司业绩下滑幅度较大，主要受行业整体需求放缓、PCB 业务产能释放较慢的影响，符合行业市场状况和公司经营情况。

电子电路铜箔方面，2021 年，受消费电子、5G 通讯、新能源汽车、汽车电子、IDC 等下游产业的快速发展，带动上游电子电路铜箔需求增加，电子电路铜箔供需偏紧，行业内企业订单充足、加工费保持较高水平，公司电子电路铜箔产品业绩较好。据中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会(CCFA)统计数据，报告期上年（2021 年）我国电解铜箔总产能达 71.8 万吨，同比增长 18.7%；总产量达 64.0 万吨，同比增长 30.9%；总销量达 63.6 万吨，同比增长 31.1%，铜箔行业整体呈现产销两旺的良好局面。2022 年以来、受经济运行周期及宏观经济环境变动等多种不确定因素的影响，下游市场需求疲软，全球电子、整机市场需求下降，包括 PC、手机、电视等领域，产业链降本压力大，铜箔需求及加工费下滑，加之原材料铜等大宗商品市场价格波动较大，导致铜箔行业业绩下滑，在去年高基数的影响下，本年业绩下滑幅度较大。

PCB 方面，2022 年度，PCB 行业热度受全球经济复苏承压、电子产业与半导体整体增速放缓、美元升值、大宗商品价格回落等多重因素影响，产值增长放缓。公司 PCB 业务系 2021 年第三季度开始试生产，受下游行业需求的影响，本年 PCB 产品的产能及销售还处于爬坡阶段，PCB 业务在本年尚未能实现盈利，对公司业绩产生负向影响。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,202,380,762.63	1,520,516,916.50	44.84%	1,141,976,650.57
归属于上市公司股东的净资产	1,667,387,900.53	693,616,453.56	140.39%	530,774,896.07
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,334,709,512.90	1,271,049,881.46	5.01%	838,473,363.21
归属于上市公司股东的净利润	70,325,814.86	162,841,557.49	-56.81%	57,639,546.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,027,793.81	153,773,110.75	-64.87%	55,723,853.96
经营活动产生的现金流量净额	13,312,585.47	22,357,333.78	-40.46%	104,835.60
基本每股收益（元/股）	0.51	1.28	-60.16%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.51	1.28	-60.16%	0.45
加权平均净资产收益率	7.37%	26.60%	-19.23%	11.48%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	382,956,395.74	370,660,404.46	287,290,814.25	293,801,898.45
归属于上市公司股东的净利润	33,315,062.76	21,709,041.47	16,294,818.77	-993,108.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,421,996.98	18,873,937.58	9,757,993.24	-6,026,133.99
经营活动产生的现金流量净额	-22,040,759.32	-25,746,799.17	108,737,332.16	-47,637,188.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,923	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,133	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
赣州逸豪集团有限公司	境内非国有法人	52.06%	88,022,985.00	88,022,985.00					
香港逸源有限公司	境外法人	10.65%	18,004,048.00	18,004,048.00					
赣州发展投资基金管理有限公司—赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	8.33%	14,088,889.00	14,088,889.00					
张剑萌	境内自然人	3.95%	6,684,078.00	6,684,078.00					
国信证券—招	其他	0.86%	1,457,627.00	1,457,627.00					

商银行—国信证券逸豪新材料员工参与战略配售集合资产管理计划						
何朝阳	境内自然人	0.25%	417,000.00			
深圳市小四喜资产管理有限公司—小四喜长江1号私募证券投资基金	其他	0.19%	317,200.00			
韩东学	境内自然人	0.15%	250,000.00			
国信证券股份有限公司	国有法人	0.13%	221,734.00			
梁尚青	境内自然人	0.13%	213,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 张剑萌持有赣州逸豪集团有限公司 100%的股权；张信宸持有香港逸源有限公司 90%的股权；张信宸系张剑萌之子，两人共同为公司实际控制人。 (2) 除前述内容外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

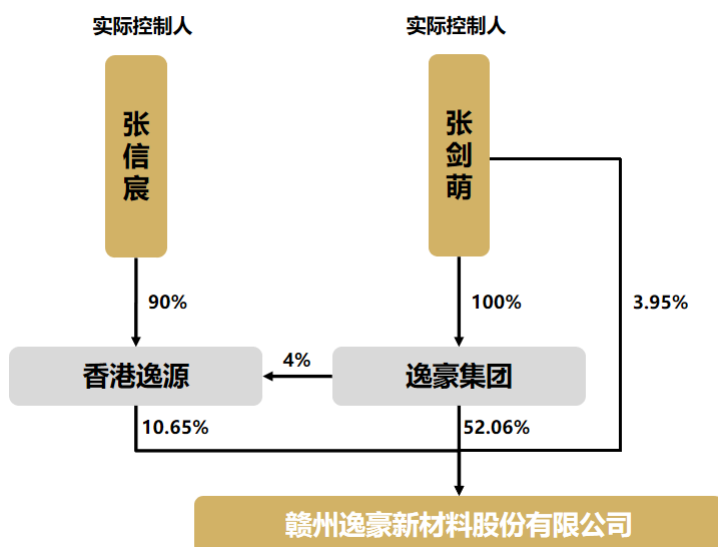
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

申请首次公开发行股票并在创业板上市事项

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1258号）同意注册，赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）4,226.6667万股，发行价格为23.88元/股，本次发行募集资金总额为100,932.80万元，扣除发行费用（不含税）10,588.24万元后，募集资金净额为90,344.56万元，其中超募资金总额为人民币15,729.86万元。募集资金已于2022年9月23日到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年9月23日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕41364号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。